

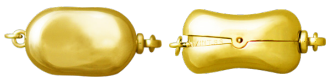
～高級真珠用クラスプの新提案～

NEW C-move WINK クラスプ
テック DS **K18** **K14WG**

金モノなのに この価格!!

- 当社の従来売れ筋品に比べ約 **40% 安い!**
- **両面デザイン**だから表裏が気にならない
- **軽くて安全**で使いやすい!

◎実物の大きさ (縦: 9.8mm 横: 15.7mm 厚み: 8.4mm)



WIN-DS603



マーメイドライン
プラグ

見えないところも美しく!
 流線型のマーメイドラインは
 日米中欧で意匠登録済

特許登録 5592031号 / 特許2件・意匠2件出願中

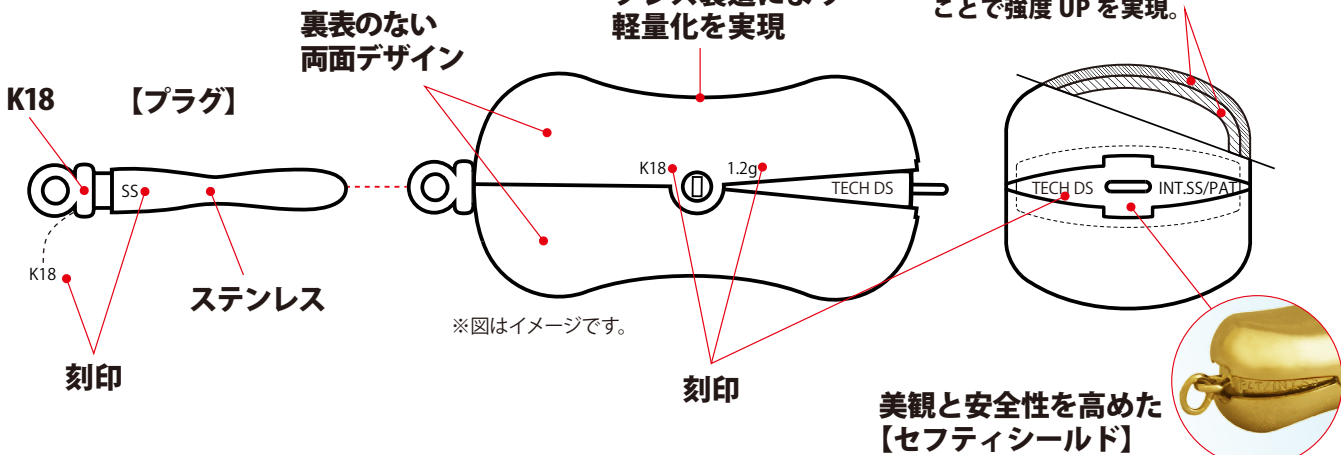
C-move WINK クラスプ テック DS の特徴 ※図はイメージです。

対応珠サイズ: 8.5mm~12.0mm

※商品仕様は変更になる場合もございますのでご了承下さい。

【DS(デュアル・ストラクチャー)構造]

K18 or K14WG ボディの下に
 ステンレスフレームを内蔵する
 ことで強度UPを実現。



仕様	本体		プラグ		カン	内部部品	金総重量	全重量
	K18	K14WG	K18	K14WG				
	K18 (5:5割※注1) / ステンレス	K14WG (Ni割※注2) / ステンレス	K18 (5:5割※注1) / ステンレス ニッケル下地金メッキ	K14WG (Ni割※注2) / ステンレス ニッケル下地ロジウムメッキ	K18	ステンレス	K18:約1.2g	約3.1g
					K14WG	ステンレス	K14WG:約1.1g	約3.0g

※注1 Au(金)75% Ag(銀)12.5% Cu(銅)12.5% ※注2 Au(金)58.5% Cu(銅)26.5% Ni(ニッケル)5% Zn(亜鉛)10%